

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
公告の方法	当社のホームページに掲載する https://www.ferrotec.co.jp/
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 スタンダード

・株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー

第2 四半期			第3 四半期			第4 四半期			第1 四半期		
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
第1四半期開示	第2四半期決算		第2四半期決算発表 第2四半期決算説明会			第3四半期開示	本決算		決算発表 決算説明会	株主総会	

Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848

URL <https://www.ferrotec.co.jp/>

UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



森林に配慮して適切に管理された森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

第44期 決算報告

2023年4月1日～2024年3月31日

証券コード：6890



Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

株主の皆さまへ



代表取締役社長
グループCEO
賀 賢漢

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

令和6年能登半島地震にて被災された皆さまにお見舞い申し上げます。ここに第44期決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

第44期は、半導体需要の調整局面となり、欧米顧客を中心とする半導体装置需要の大きな落込みがみられたなか、当社グループは中国半導体顧客の需要取り込みや、パワー半導体分野やクリーンエネルギー分野への注力でカバーし、前年を上回る創業来過去最高の売上高となりました。前中期計画3カ年を振り返りましても、実施前年度の売上高913億円から2,224億円と事業規模を倍以上に成長させることができただけでなく、供給能力の面でもお客様に喜んでいただけたと認識しております。

当社グループはこの2024年5月に新たな3カ年の中期経営計画(25/3月期から27/3月期まで)を発表いたしました。2025年以降予想される需要増大を最大限取り込む意欲的な目標数値を設定し、力強い成長を志向してまいります。今期は、前期までに増産投資を行ってきた中国国内(常山地区、四川等)やマレーシア北部(クリム)の製造拠点の円滑な立上げを行うとともに、建設中のマレーシア南部(ジョホールバル)、日本の熊本、石川の工場建設を進めてまいります。

これら施策を進めてこれましたのも、ひとえに株主の皆さまのご理解、ご支援の賜物であると感謝いたしております。

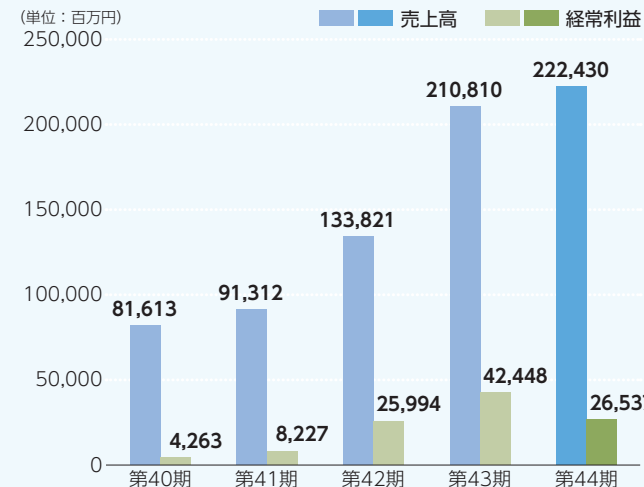
当社グループはこれからも事業成長を追求し、株主の皆さまにとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けるよう努めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

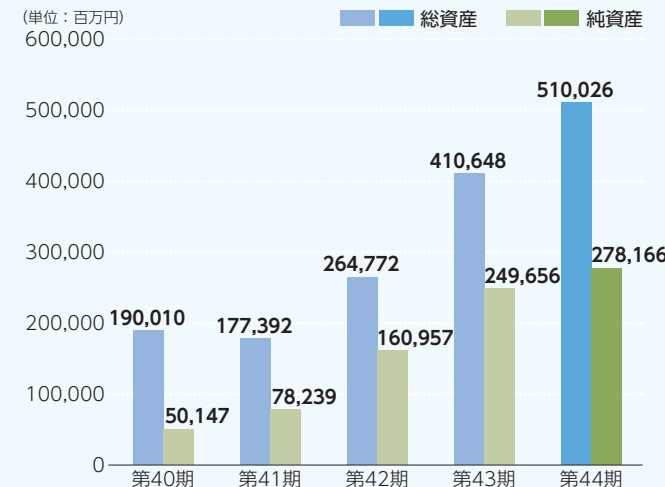
2024年7月吉日

財務ハイライト

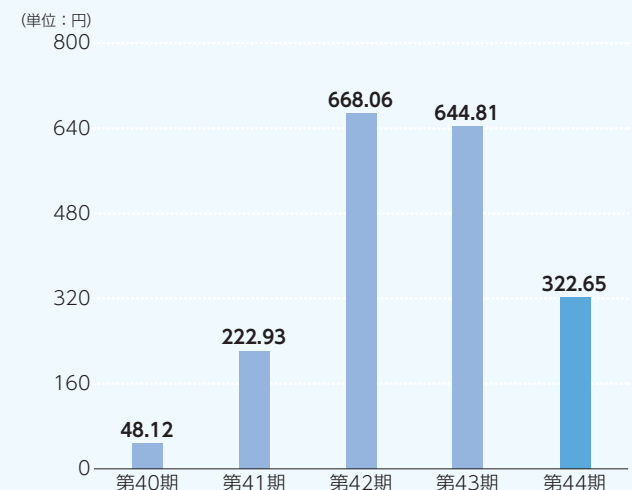
売上高／経常利益



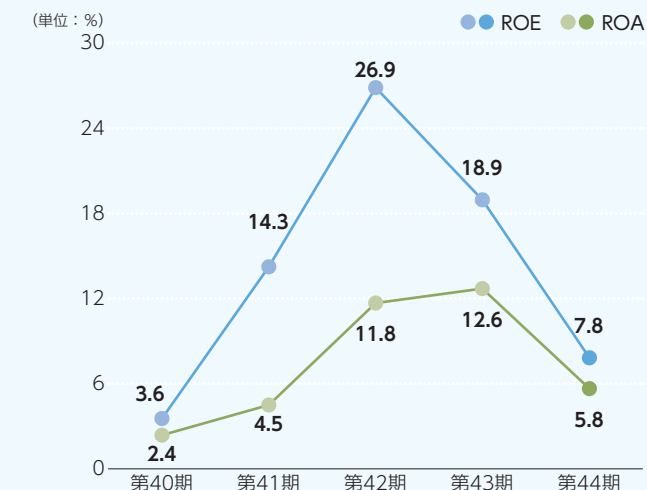
総資産／純資産



1株当たり当期純利益



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)



新中期経営計画アウトライン

▶ 策定における前提

内部環境

- 国際状況や為替水準等の急激な事業環境の変動に機動的に対応するため、ローリング形式での中期計画を策定
- 市場の再加速に向け2025年3月期をピークに設備投資を継続し、前中期目標と同規模の投資額となりうるものの、2025年3月期以降は資本効率化に向けて、一定程度設備投資をコントロールする方針
- 設備投資のコントロールと工場のフル稼働化による収益性の向上と、それに伴う営業キャッシュフローの増加により、フリーキャッシュフローは2027年3月期にプラスに転じる見通し

▶ 基本方針

事業成長	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 半導体、自動車関連の事業成長を追求し、業界上位の事業を拡大させる ▶ マレーシア、日本工場が中国外製造品の需要を取込み、中国工場が中国製造品の需要を取込む体制を強化する
生産効率・競争力の強化	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 当社の量産能力を更に高めるため、デジタル化・自動化等を進め、工場の生産効率向上・競争力強化を追求する ▶ 「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続、研究開発体制を強化、新製品・新技術の開発を推進する
人材強化・企業文化	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 人材重視を重要な経営戦略と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充、株式報酬制度(RSU・PSU)導入を進める ▶ 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を活動指針に掲げ、浸透を進める
財務・株主還元	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 新增設工場の早期立上げ・業績貢献により、収益増強を図る ▶ 株主還元増加を重視、配当性向は20%～30%を意識、株主還元の拡充に努める

▶ KPI

(金額の単位は百万円)	24/3期(実)	25/3期(予)	26/3期(計)	27/3期(計)
売上高	222,430	235,000	300,000	380,000
営業利益	24,872	26,000	40,000	60,000
営業利益率	11.2%	11.1%	13.3%	15.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	15,154	16,000	22,000	30,000
ROE	7.7%			15%
ROIC*	4.4%			8%
自己資本比率	40%	40%		
設備投資	75,227	60,000	40,000	40,000
1株当たり配当金(年間)	100.0円	100.0円	財務・投資機会の状況を考慮 配当性向20%～30%を意識、 拡充に努める	

* ROIC = 親会社帰属純利益 / (有利子負債 + 純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

▶ 設備投資計画

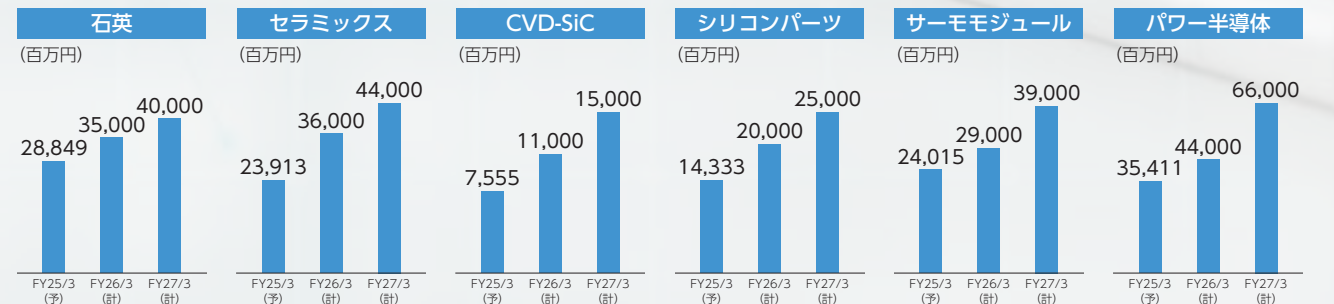
- 3か年の設備投資は累計1,400億円を計画、M&Aは投資機会により変動するが100億円を想定
- マレーシア投資設備支払い時期が25/3期に一部ズレた影響等あり。21/3～24/3投資金額は計画1,950億円に対し1,825億円※、計画比マイナス125億円

※ 24/3期子会社株式取得(財務CF計上)を含む

25/3期～27/3期累計
設備投資
1,400億円

- ▶ 半導体関連顧客からの2025年以降のキャパシティ増強の要請へ対応
- ▶ 中国外生産体制を強化
- ▶ パワー半導体基板等の自動車セグメントへの投資を継続
- ▶ 営業CFの増加により、フリーCFは改善見通し

▶ 注力製品別売上高目標



事業成長

マレーシア/クリムで半導体製造装置部材・サービスの工場稼働開始

当社がマレーシア投資開発庁(MIDA)の支援のもとマレーシア北部ケダ州クリムハイテクパークに建設を進めていた半導体等装置関連の工場が完成、2024年1月15日に生産開始を祝うグランドオープニングセレモニーを開催いたしました。セレモニーは、ケダ州首席大臣等のマレーシア政府幹部や顧客企業も列席のもと盛大に実施されました。当社は本工場を軸に、マレーシアをはじめとする東南アジア地区の顧客ニーズを取り込み事業拡大を目指します。また、半導体製造装置分野における先端材料製造・組み立ての世界的リーダーとなるよう努めてまいります。



ロボット組立

大容量
半導体前工程製造装置向け

フェローテックのロボット組立品は、半導体産業の顧客から要求される重要なプロセス制御を支援するために必要な高い生産量と持続的な品質を確保するために設計および製造されています。当社は、設計、ソフトウェア制御、製造、在庫保管、供給など、コンセプトから完成まで、単純な部品製造および組み立てから完全なプロジェクトアウトソーシング機能まで、実に幅広いサービスを提供しています。



金属加工

大規模チャンバーおよび精密部品の製造

フェローテックは、高度な高精度加工機器を使用し、お客様の図面に基づいて製品製造サービスを提供しています。また、設計、製造、テスト、コンサルティングなど、お客様のニーズを満たすための完全な精密加工ソリューションも提供しています。フェローテックは、日本と米国からの先進的な製造コンセプトを採用、リーンマネジメントを実施することにより生産効率改善とお客様のコストベネフィットとリードタイムの最大化を続けてまいります。



石英加工品

MCによる精密加工と火加工プロセス

半導体製造プロセスでは、高熱と化学物質による処理が頻繁に行われます。ここで使用されるのは、超高純度シリカガラスで構成された石英製品です。薄膜生成や拡散プロセス、ウエーハのエッチングプロセスにおける消耗品として、当社の石英製品はますます薄型化・高純度化する半導体の加工において重要な役割を果たしています。



ファインセラミックス

高純度セラミック材料部品の製造

フェローテックは、最も厳格な品質管理条件下で、高度な材料技術、生産技術、および精密加工技術を活用した、さまざまなセラミック材料の統合生産を行っています。当社のセラミック製品は、高純度、高剛性、高精度が求められる半導体製造工程に適した高品質部品として広く採用されています。



表面処理

高度な表面処理条件に適合する幅広い特殊プロセス

フェローテックは、自社開発の技術とノウハウを活かした表面処理特殊工程を完備しています。当社の金属表面処理は、半導体チップ製造工程における高耐食性、絶縁破壊電圧の向上、ますます厳しくなる清浄度要件を満たすことができるよう対応されておりま。



デジタル化・自動化・品質管理

生産現場のデジタル化・自動化・見える化を水平展開

中国生産拠点でERP、MESを始め、さまざまなシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現(AI活用、ロボットの積極導入)。また、自動化・省人化・効率化により、工場の競争力・優位性の強化を推進し、日本やマレーシア新拠点でも自動化投資を積極化・水平展開してまいります。



自動搬送システム



自動倉庫システム



自動検査装置

モノづくりにおけるDX化を推進し、生産性および品質の向上に取り組む

人材強化・企業文化

優秀な人材の確保、人材育成への対応を国内外で展開

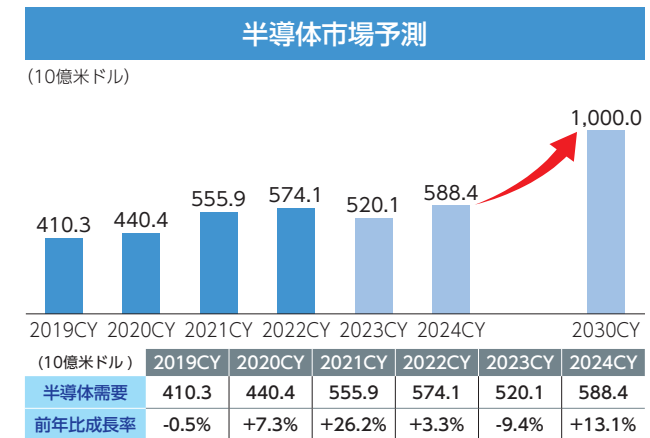
事業成長を実現するため、人材重視を重要な経営方針と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充等を積極的に進める。また、事業・地域を超えたコミュニケーションを活発にし、企業文化を共有し、協働の輪を広げてまいります。

中国においても高度人材の採用を積極的に進めており、上海の中国本社や各事業の研究院で製品開発等に取り組む

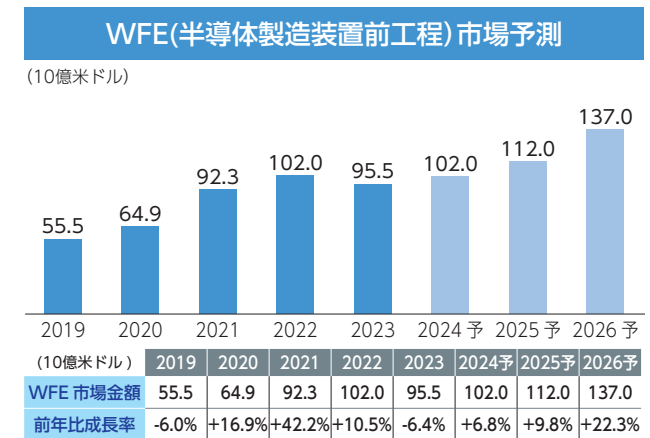


外部環境予測

- 半導体市場は2030年には1兆米ドルを超える規模となり、製造装置需要も2024年から上昇基調
- 米中半導体摩擦の影響はあるものの、ボリュームゾーンを押さえる中国は成長が見込まれると予想



*出典:WVSTS等のデータを基に当社作成



*某証券会社資料を基に当社作成

特集 3 半導体市場の本格回復が見込まれる2025年下期に向けて
常山工場の投資が完了し、いよいよ本格稼働

中国・半導体市場の高い成長ポテンシャル

当社は、中国常山地区(浙江省衢州(くしゅう)市常山県)において集中的に増産投資を行っておりますが、2023年7月に第三期の増産投資案件である「セラミックス」「シリコンパーツ」「CVD-SiC」の3製品の工場が竣工し、生産を開始いたしました。特に「CVD-SiC」は中国での製造を初めて手掛けることとなります。

常山地区は最新鋭の量産工場を建設することにより、製品の供給能力と収益性の向上に貢献してきました。上記3製品に加え、従来から製造する「石英」「真空シール・金属受託加工」「サーモモジュール」の量産も手掛け、当社中国製造における旗艦(フラッグシップ)工場と位置付けることができます。

今後ものづくりの力を磨き続けるとともに、旺盛な中国顧客の需要に応えることで、更なる事業拡大を図ってまいります。

浙江省常山

第二期工場：量産拡大中



第三期工場：23年7月竣工





石英



金属加工



サーモモジュール



セラミックス



シリコンパーツ

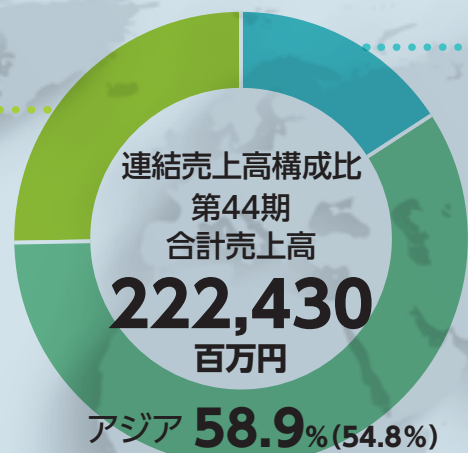


CVD-SiC

“これまでの投資成果の収穫期へ”
中国・半導体市場の高い成長ポテンシャルも背景に
半導体需要を着実に取り込んでいく

地域別売上高構成比

※()は前期の数字



欧米 **25.1%**(31.1%)



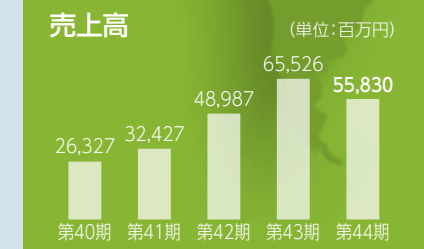
日本 **16.0%**(14.1%)



アジア **58.9%**(54.8%)



各エリア別のポテンシャル



欧米エリア

- 24/3期は前期比▲14.8%の減収。半導体業界の調整局面となり、顧客である大手製造装置メーカーからの大幅な受注減に直面、半導体材料製品をはじめ、サーモモジュールなども売上を落とした。一方、パワー半導体基板は継続して増収となった
- 25/3期は欧米顧客からの注文増は年後半にかけて緩やかに回復するものと認識している



アジアエリア

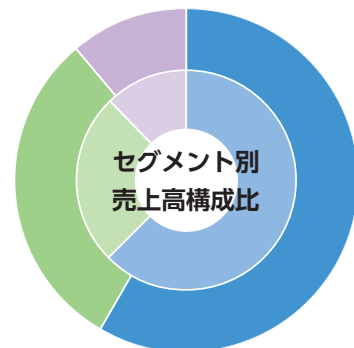
- 24/3期は前期比+13.3%の増収。半導体材料製品、金属受託加工などは中国ローカルメーカーからの受注増の下支えがあったものの、欧米顧客からの需要減の影響を受けトータルでは減収。一方、パワー半導体基板事業は中国EV向けAMB基板、一般産業向けDCB基板が順調に売上を伸ばした。また、石英坩堝も太陽光パネルメーカー向けに大型坩堝のラインを増設したことが奏功し、大きく売上を伸ばすことができた
- 25/3期も半導体等装置関連事業で中国国内メーカーからの需要は比較的堅調に推移するとみている



日本国内

- 24/3期は前期比+20.2%の増収。子会社化したセンサ(大泉製作所)、ソーブレード(東洋刃物)の事業等が純増となったことが増収の主要因だが、需要に対し供給能力が不足するCVD-SiC製品も生産能力の増強もあり、売上を伸ばした
- 25/3期は熊本、石川の工場建設を急ぎ、量産能力の強化を行っていく

セグメント別事業概況



当社は、製品用途の類似性と販売先業種により区分し「半導体等装置関連事業」「電子デバイス事業」の2事業を報告セグメントとしております。

半導体等装置関連事業
電子デバイス事業
その他

	第43期 (内周)	第44期 (外周)
半導体等装置関連事業	62.7%	58.5%
電子デバイス事業	25.2%	30.4%
その他	12.1%	11.1%

半導体等装置関連事業

真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品や半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品(石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等)、部品洗浄サービスは、半導体の設備投資需要の停滞および設備稼働率の低下に加えて、マテリアル製品等の在庫調整の影響で売上が減少しましたが、中国ローカルの半導体製造装置メーカー向け販売の強化、太陽光パネル製造メーカー向けの大型坩堝製品、CVD-SiC製品でカバーしました。

売上高 **1,300**億円 営業利益 **162**億円

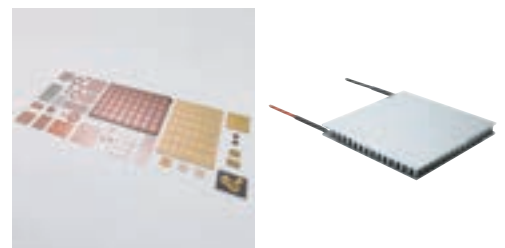


セラミックス製品 真空シール

電子デバイス事業

サーモモジュールは、PCR検査装置用途が大きく減少しましたが、通信分野向け、特に生成AI関連で注目される大容量の光トランシーバー向けが伸びたことで減少をカバーし、全体では増収となりました。パワー半導体基板は、DCB基板が産業機械向けなどで売上を伸ばし、AMB基板も中国EV向けで堅調に推移し、全体でも大きく売上を伸ばしました。また、センサは前第2四半期連結会計期間より株式会社大泉製作所を連結化したため、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

売上高 **676**億円 営業利益 **108**億円



パワー半導体基板 サーモモジュール

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。

連結財務諸表(要約)

決算情報についての最新情報、詳細につきましては当社のIRサイトをご覧ください。
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当期 2024年3月31日現在	前期 2023年3月31日現在
資産の部		
流動資産	248,408	215,341
固定資産	261,618	195,306
有形固定資産	201,339	139,610
無形固定資産	6,611	6,949
投資その他の資産	53,666	48,745
資産合計	510,026	410,648
負債の部		
流動負債	122,148	111,294
固定負債	109,712	49,697
負債合計	231,860	160,991
純資産の部		
株主資本	177,638	166,955
その他の包括利益累計額	26,771	16,773
新株予約権	-	40
非支配株主持分	73,756	65,887
純資産合計	278,166	249,656
負債純資産合計	510,026	410,648

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	前期 2022年4月1日から 2023年3月31日まで
営業活動による キャッシュ・フロー	28,720	43,024
投資活動による キャッシュ・フロー	△92,400	△68,760
財務活動による キャッシュ・フロー	60,419	68,718
現金及び現金同等物に係る 換算差額	4,162	344
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少)	901	43,326
現金及び現金同等物の 期首残高	95,905	52,579
連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	-	△0
現金及び現金同等物の 期末残高	96,806	95,905

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	前期 2022年4月1日から 2023年3月31日まで
売上高	222,430	210,810
売上原価	152,573	138,728
売上総利益	69,856	72,081
販売費及び一般管理費	44,984	37,038
営業利益	24,872	35,042
営業外収益	8,002	9,872
営業外費用	6,337	2,466
経常利益	26,537	42,448
特別利益	754	856
特別損失	1,145	1,263
税金等調整前当期純利益	26,146	42,041
法人税等	5,510	7,753
当期純利益	20,635	34,288
非支配株主に帰属する当期純利益	5,481	4,585
親会社株主に帰属する当期純利益	15,154	29,702

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	前期 2022年4月1日から 2023年3月31日まで
当期純利益	20,635	34,288
その他の包括利益	13,063	4,559
その他有価証券評価差額金	982	△130
為替換算調整勘定	10,120	3,027
退職給付に係る調整額	177	99
持分法適用会社に対する持分相当額	1,784	1,563
包括利益	33,699	38,847
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	25,212	32,964
非支配株主に係る包括利益	8,486	5,882

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株式情報 / 会社情報 (2024年3月31日現在)

株式の状況

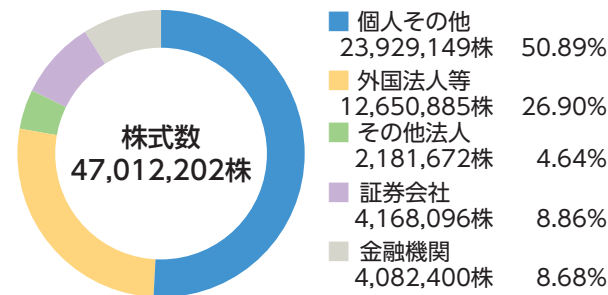
発行可能株式総数	100,000,000株
発行済株式総数	47,111,567株
株主数	43,800名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	933,500	1.98
山村 章	853,200	1.81
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	852,200	1.81
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	756,598	1.60
JP MORGAN CHASE BANK 385632	711,077	1.51
INTERACTIVE BROKERS LLC	707,000	1.50
JPモルガン証券株式会社	681,390	1.44
JP MORGAN CHASE BANK 385781	640,400	1.36
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	626,000	1.33
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	586,400	1.24

(注) 1. 当社は、自己株式99,365株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況



(注) 1. 自己株式99,365株は上記の円グラフ中の株式数に含まれておりません。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

商号	株式会社フェローテックホールディングス (英文表記) Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
資本金	295億3,992万4,302円
株式公開	株式会社東京証券取引所 スタンダード 1996年10月18日(証券コード: 6890)
決算期	3月31日
従業員数	14,192名(連結)

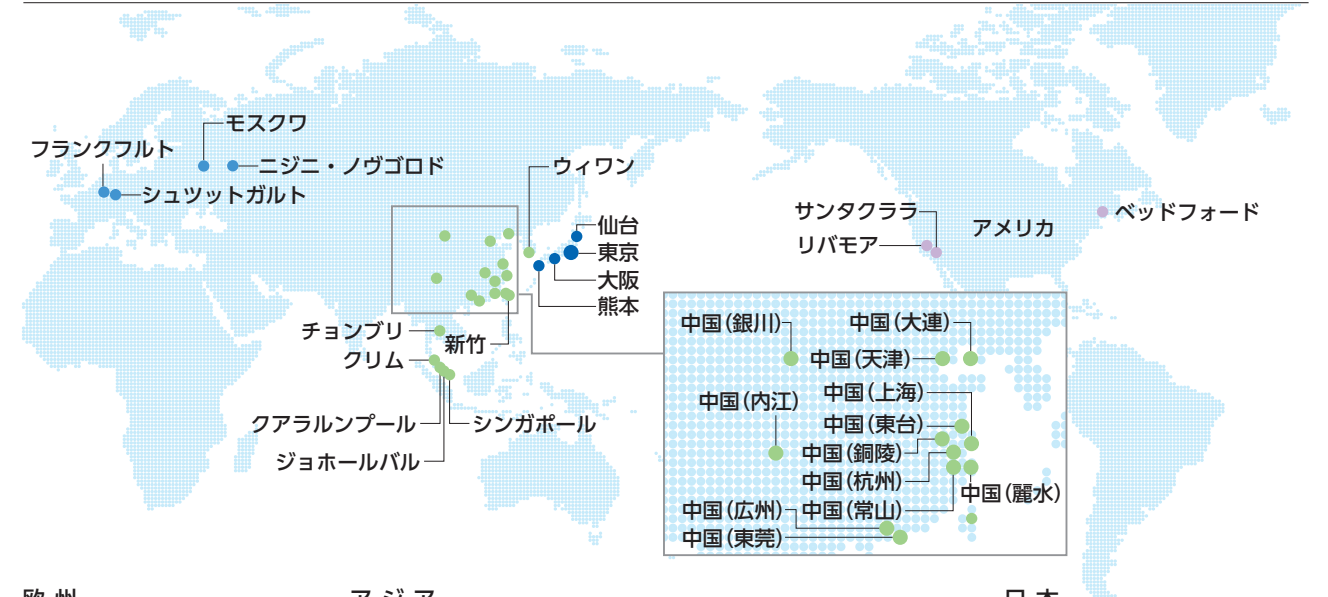
所在地

本社 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-3-4
日本橋プラザビル5階

役員 (2024年6月27日現在)

取締役	
代表取締役社長	賀 賢 漢
代表取締役副社長	山 村 丈
取締役	並 木 美 代 子
取締役	大 石 純 一 郎
取締役	武 田 明
取締役	佐 藤 昭 広
社外取締役	岡 田 達 雄
社外取締役	坂 本 明 彦
社外取締役	磯 巧
監査役	
常勤監査役	若 木 啓 男
社外監査役	松 本 拓 生
社外監査役	大 樂 弘 幸

グローバルネットワーク



欧州

- フランクフルト (ドイツ)
- シュツットガルト (ドイツ)
- モスクワ (ロシア)
- ニジニ・ノヴゴロド (ロシア)

アジア

- 杭州
- 上海
- 銀川
- 銅陵
- 東莞
- 内江
- 広州
- 麗水
- 大連
- シンガポール
- 新竹 (台湾)
- ウィワン (韓国)
- クアラルンプール (マレーシア)
- クリム (マレーシア)
- ジョホールバル (マレーシア)
- チョンブリ (タイ)

日本

- 東京 [本社]
- 千葉
- 兵庫
- 石川
- 岡山
- 神奈川
- 大阪
- 熊本
- 仙台
- 山形
- 埼玉
- 青森
- 宮城

米国

- ベッドフォード
- リバモア
- サンタクララ

販売拠点 生産拠点